

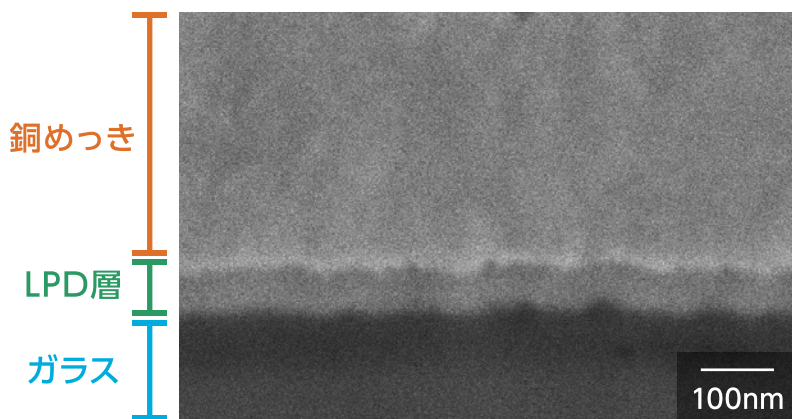
PLOPXプロセス

ガラス基板への無電解銅めっきプロセス

※ パナソニック環境エンジニアリング株式会社と共同開発

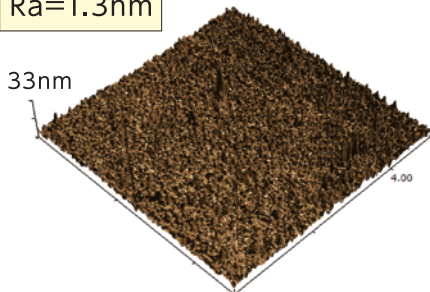
- ▶ 液相析出法 (Liquid Phase Deposition; LPD法) により金属酸化物層を形成したガラス基板への無電解銅めっきプロセス
- ▶ ガラス基板に対して高いピール強度が得られる
- ▶ つきまわり性が良く、TGVへの析出性に優れる

ガラス基板で高いピール強度が得られる

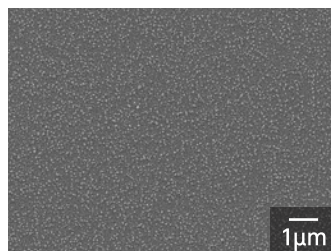


ガラス/LPD層/めっき断面SEM像

Ra=1.3nm

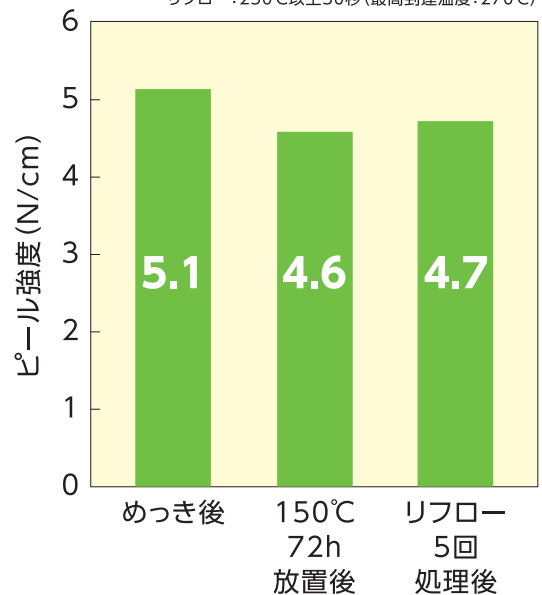


LPD層表面AFM像

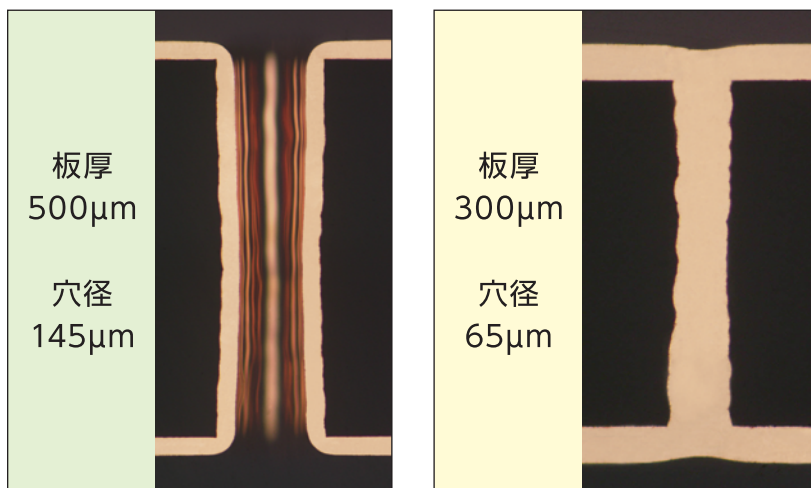


LPD層表面SEM像

リフロー: 250℃以上30秒 (最高到達温度: 270℃)



スルーホールめっき析出性に優れる



硫酸銅めっき後のTGV断面像

処理工程

